单组份导电银胶KXS84-1

产品简介

- KXS84-1 是一款单组份导电银胶。其粘度低，流变性好，点胶工艺性能优异，高速点胶时，无拉丝和拖尾。且固化后，导电性能好，粘接强度高。该胶在半导体芯片的贴合上有广泛的应用，适用于全自动机器高速点胶。

产品特点

- 流变性好，点胶工艺性能优异；导电性好，粘接强度高，适用于全自动机器高速点胶。

典型性能

	测试项目		单位	特定值	测试方法
固化前性能	外观		/	银灰色膏体	目测
	粘度		Pa.s	8.5	Brookfield粘度计 @25℃
推荐固化条件： 175℃*60min					
固化后性能	密度		g/cm³	4.0	ASTM D792
	热膨胀系数（CTE）		ppm/℃	α1：41	TMA
			ppm/℃	α2：140	TMA
	体积电阻率		Ω•cm	$1.01*10^{-4}$	四探针法
	导热率		W/m.k	2.5	Laser Flash 法
	粘接强度	剪切强度	Mpa	≥16	钢-钢
		推力	N	12	0.3mmSi Ag/Cu基板，@25℃
				> 100	2mmSi 芯片 Ag/Cu基板，@25℃

使用方法：

- 解冻：使用前需将银胶解冻恢复至室温，解冻时针筒竖直放置，解冻时间1-2h.
- 使用：银胶解冻后需在10h内使用完，建议室温25℃，湿度50%RH环境下使用。
- 固化：175℃烘烤60min。

包装和存储：

- 包装规格分别为：3CC/支； 5CC/支； 10CC/支； 30CC/支；其他可根据客户要求定制。
- 保存最佳温度为-40℃-10℃，保质期为6个月。
- 注意：产品在运输和储存的过程中，应注意防潮、防止污染、避免高温、避免阳光直射；产品应保存在清洁、干燥、无明火的环境中。收到货后，请立即放入冰箱保存。

联系我们：
蒋丹萍152-6144-8356；张艳138-5168-3378；荣岩180-6607-5325；田晓冰152-5095-2541；许飞艳132-7663-5250；杨慧子159-9624-3638